

主催：（日本側）岩手大学分子接合技術研究センター
（台湾側）三建産業情報社（SUMKEN）（台湾日本交流事業）
共催：i-SB事業化プラットフォーム
（運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター）
後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

半導体材料に関するセミナー

日本台湾半導体交流セミナー(第4回)

日本企業と台湾企業の交流を目的とする、半導体材料に関するセミナーです

2024

12/13 (Fri)

14:00-18:00 (JST)

オンライン (逐次通訳つき)

< 14:00-15:50 >

1) 半導体パッケージ：汎用人工知能（GAI）時代の異種チップ集積技術
SiPlus 代表取締役兼CEO 胡 迪群 (Hu Di Cyun)

< 16:00-18:00 >

2) 東レの半導体関連材料

東レ株式会社 シニアフェロー 富川 真佐夫 (Tomikawa Masao)

参加費：2,000円（消費税込・資料付き）

- ・セミナー終了後、5営業日以内に、参加費の請求書をメールでお送りします。請求書に記載の期限までに（2025年1月末日を予定）、参加費のお振り込みをお願いします。
- ・参加者には、12/6以降（申込期限以降）、ミーティングリンクをお送りします。

事前申込制・申込期限

12/6 (Fri)

下記URLまたはQRコードを読み込んでお申し込み下さい。

<https://i-sb.ccrd.iwate-u.ac.jp/news/post-189/>



岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォーム運営主体の中核組織として、分子接合技術（i-SB法®）と樹脂精密設計技術のものづくり分野における幅広い普及と、それによるプロセスとプロダクトのイノベーション創出を目指す活動を展開しています。

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）

✉ isb-office@iwate-u.ac.jp

🌐 <https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>